

YDIV18-02082C1

2 - 8GHz 功分器

数据手册



四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品简介

YDIV18-02082C1 是一款高性能 GaAs MMIC 功分器芯片，工作频率 2 到 8 GHz。该芯片具有 0.9dB 的插入损耗，隔离度大于 17dB。

关键技术指标

- 工作频段: 2 ~ 8 GHz
- 隔离度: 17dB
- 插入损耗: 0.9 dB
- 芯片尺寸: 1.00mm x 0.80mm

应用领域

- 通信
- 仪器仪表



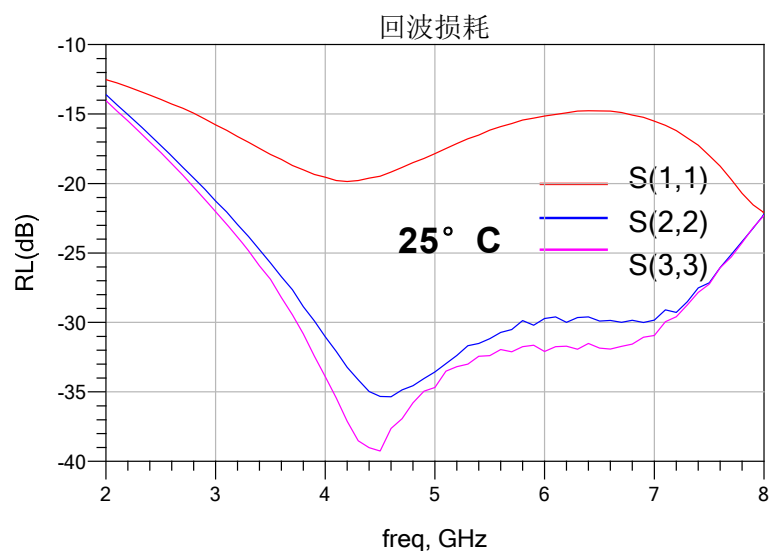
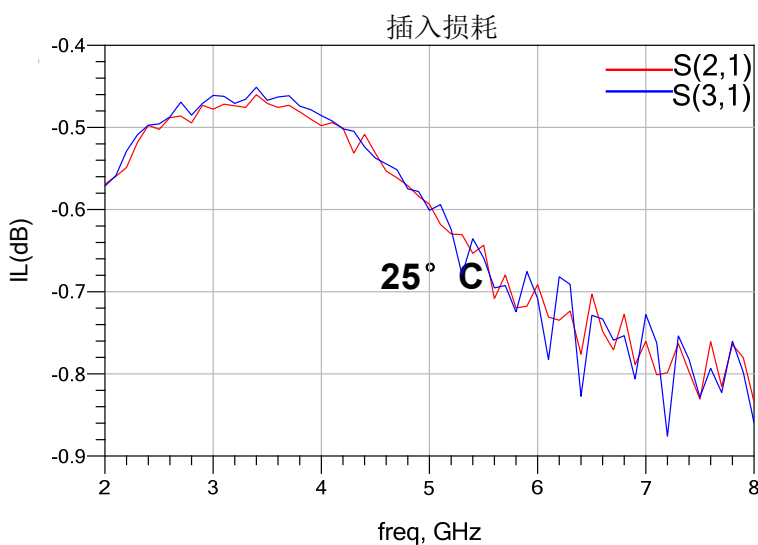
电性能表 (TA=+25°C)

指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2- 8			GHz
输入驻波	-	1.7	-	-
输出驻波	-	1.5	-	-
插入损耗	-	0.9	-	dB
隔离度	-	17	-	dB

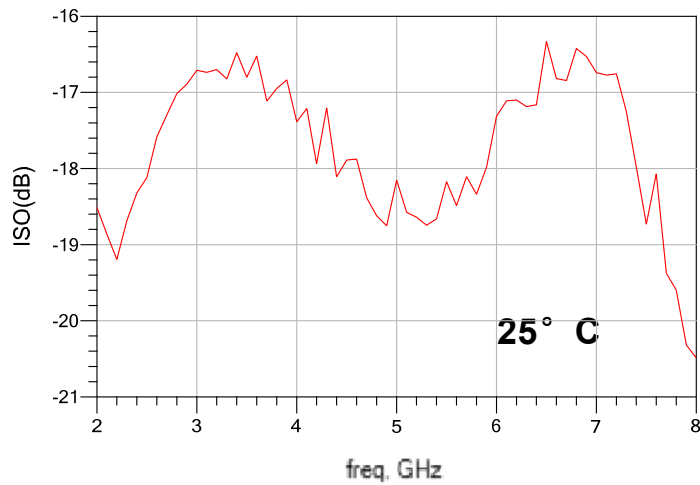
绝对额定最大值

参数	符号	数值
存储温度	T _{STG}	-65°C~150°C
使用温度	T	-55°C~85°C

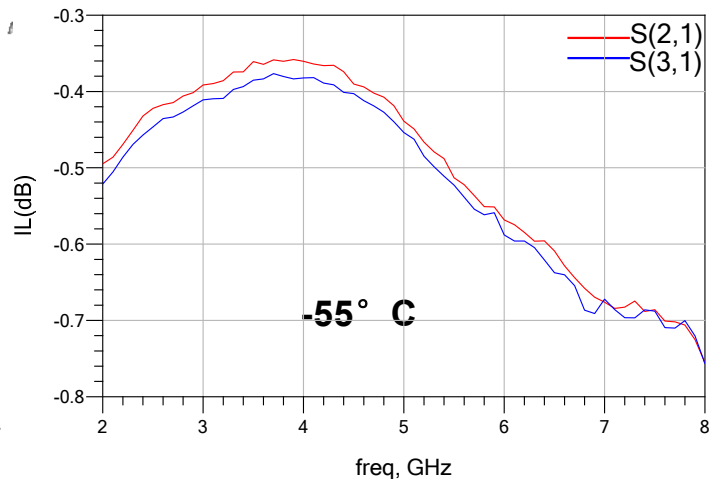
典型测试曲线



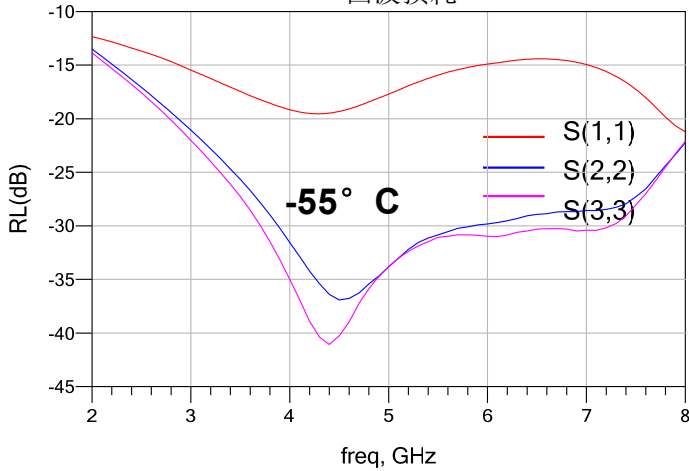
隔离度



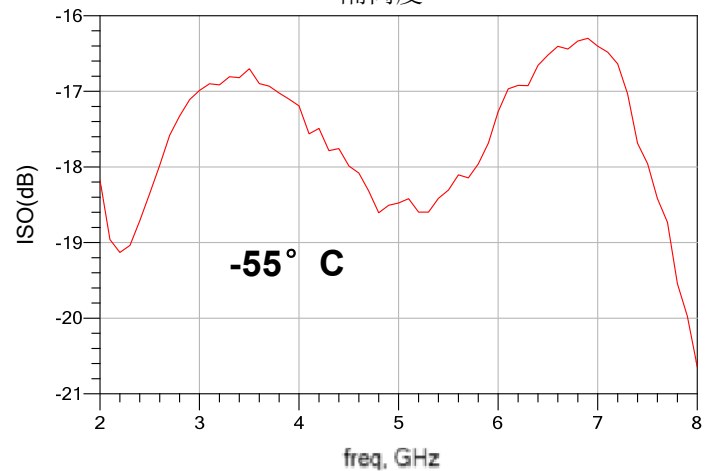
插入损耗



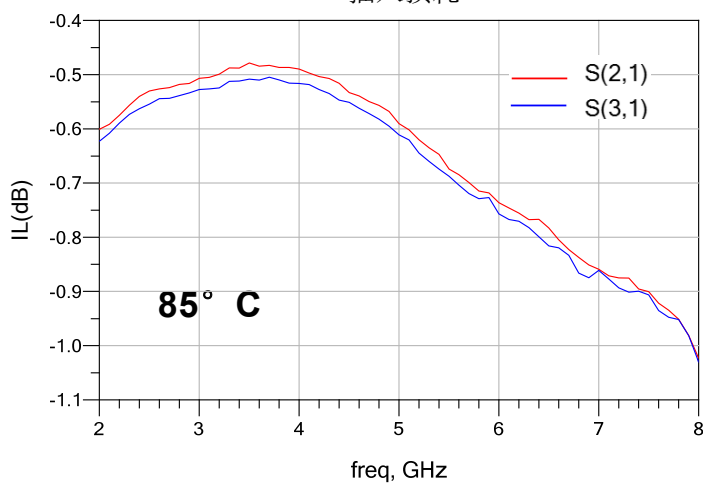
回波损耗



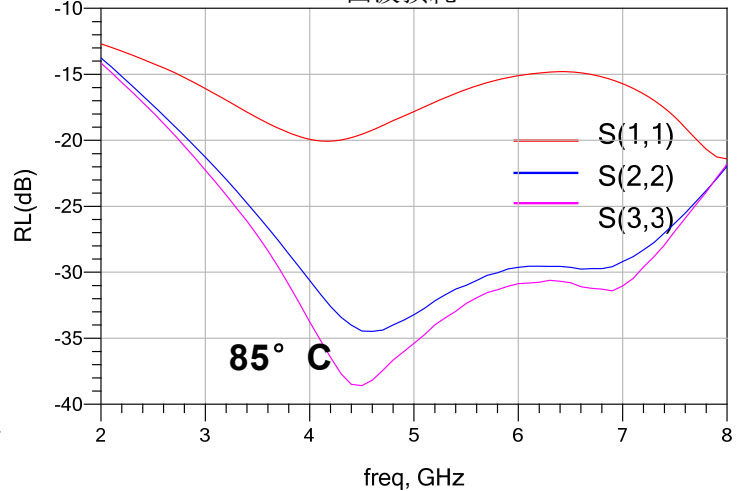
隔离度



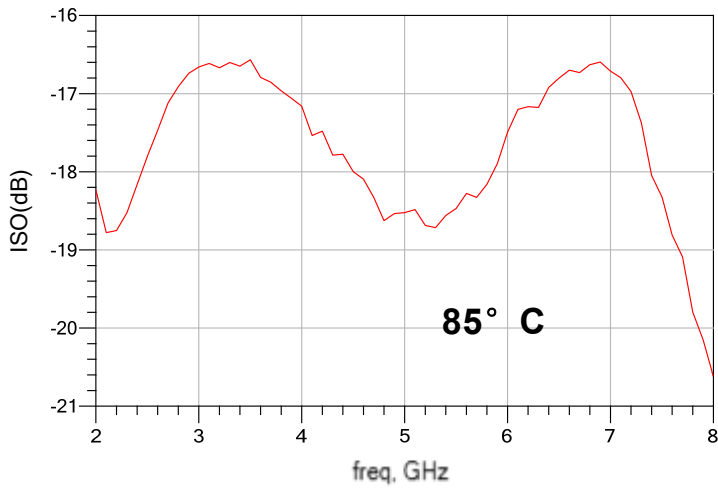
插入损耗



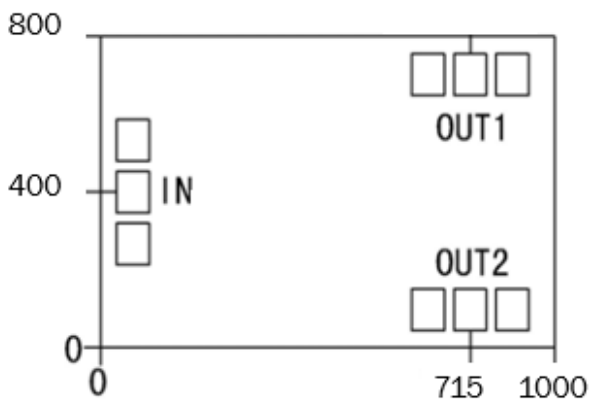
回波损耗



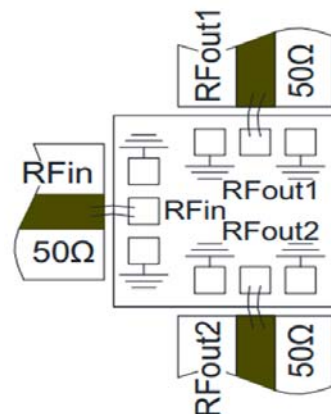
隔离度



外形和端口尺寸 (μm)



推荐装配图



端口定义

端口名	定义	信号或电压
RFIN	射频输入	RF
RFOUT1	射频输出1	RF
RFOUT2	射频输出2	RF

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境中使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 $\Phi 25\mu\text{m}$ 双金丝键合，建议金丝长度 250~400 μm ；
5. 芯片微波端无隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。